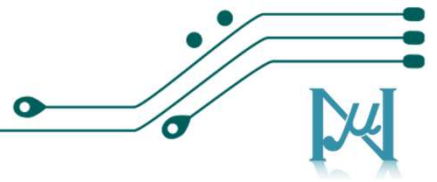


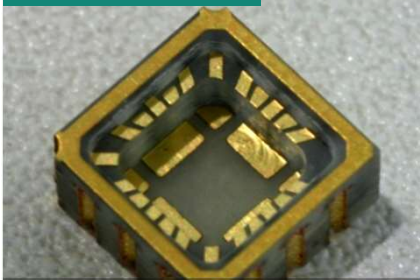
キャビティ基板

Cavity PCB



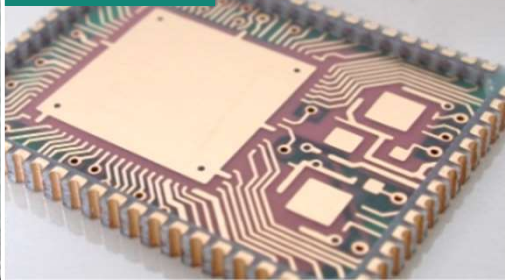
多層基板またはビルドアップ基板の必要な内層パターン(ボンディングパット、グランド層等)を高
度な加工技術により露出させ、キャビティ構造の各種パッケージ&モジュール基板を製作します。

2 段キャビティ



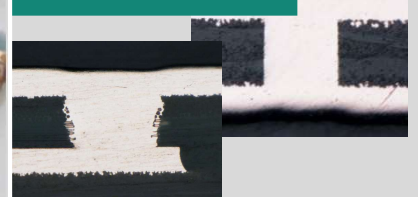
多段層のキャビティ形成が可能

側面電極



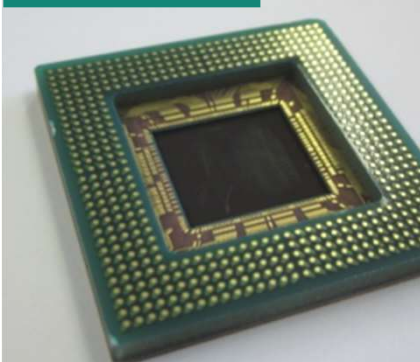
半裁したサイドスルーホールを有するPLCC
とキャビティ構造の組み合わせが可能

スルホールフィールド フィールドビア

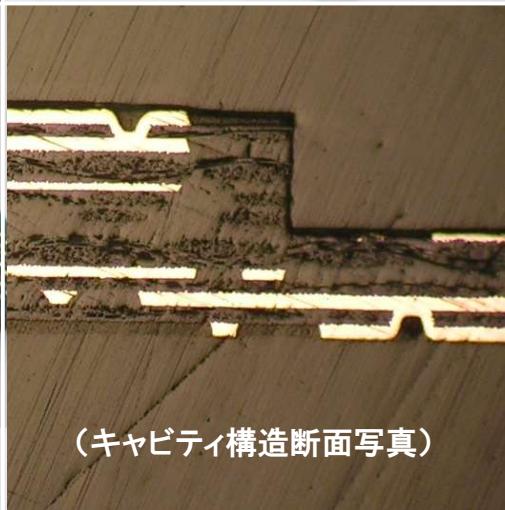


レーザービア・スルホール内をCuメツ
キにて塞ぐことが可能、キャビティ構
造との組み合わせも可能

金属貼り合わせ



キャビティ構造と金属板との貼り合
わせにより、基板の放熱性が向上



(キャビティ構造断面写真)

サーマルビア



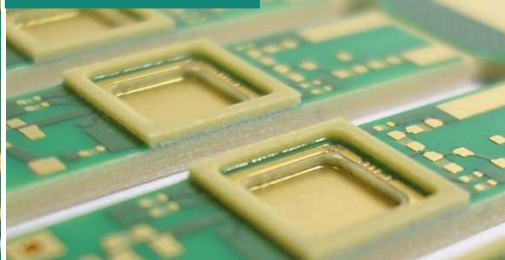
キャビティ底面にスルーホールを形成
し、裏面へ熱を導きます。

銅箔削り出し



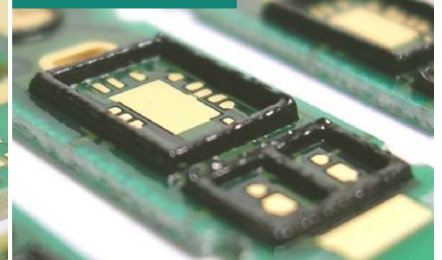
裏側の銅箔を表側から削り出すこ
とにより、基板の放熱性が向上

枠板貼り合わせ



キャビティ基板と封止枠の貼り合わせが可
能

高いダム印刷



0.1~0.8mm程度の高いダムとキャビ
ティ構造の組み合わせが可能



日本ミクロン株式会社

www.nihon-micron.co.jp

☎ 0266-23-8373

(土日・弊社指定休日を除く8:30~17:20)

✉ nmadpt@nihon-micron.co.jp

FAX 0266-23-1223

